

周报：长江存储启动 IPO 辅导，MLCC 价格有望迎来反转

核心观点

半导体：英特尔或借 EMIB-T 打入英伟达供应链；高端需求扩张与消费类渠道囤购升温有望催化 MLCC 价格反转；ADI 拟收购 Empower；长江存储启动 IPO 辅导；苹果硬件团队进行第二轮重组；俄罗斯联邦储蓄银行拟采购中国 AI 芯片；AMD 计划在中国台湾投资超 100 亿美元；消息称台积电推进 310×310 毫米面板级封装。

消费电子：五一期间中国智能手机销量下降 16%；2026 年 Q1 东南亚智能手机市场平均售价同比大增 19%。

汽车电子：中国汽车零部件已渗透美国市场；禾赛成为奔驰 L3 激光雷达战略合作伙伴，将于泰国工厂投产。

行业动态信息

1、半导体：长江存储启动 IPO 辅导；高端需求扩张与消费类渠道囤购升温有望催化 MLCC 价格反转。

据证监会网站披露，长江存储控股股份有限公司在湖北证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为中信证券。据路透社此前报道，长江存储计划最快在 2026 年 6 月中旬正式递交科创板 IPO 申请材料。长江存储 2026 年第一季度营收突破 200 亿元人民币，同比增长约 100%。强劲的业绩增长主要受益于全球存储芯片市场，特别是 AI 驱动下的数据中心需求爆发。

根据 TrendForce 调查，旺盛的 AI 芯片需求导致高端 MLCC 供需偏紧，并压缩消费类 MLCC 供货，促使部分代理商展开预防性囤购，供应商则以调价回应。近期 ODM 与供应商议价结果也显示，整体 MLCC 价格平均降幅创下近三年新低，显示 MLCC 价格循环已来到反转向上的关键点。根据 TrendForce 调查，部分 ODM 已于 5 月上旬完成 2026 年第三季议价。在供应链涨价氛围带动下，整体 MLCC 价格平均降幅不到 0.5%，创近三年新低，充分反映卖方定价话语权正显著回升。随着多数 ODM 从 5 月下旬起陆续展开新一轮议价，目前的氛围是否能催化 MLCC 价格全面反转，将成为后续观察重点。TrendForce 表示，当前高端 MLCC 受 AI Server 及 ASIC 封测订单驱动，供给偏紧，短期内难以改善；消费类产品方面则因 Taiyo Yuden 已涨价、SEMCO 评估跟进，价格底部支撑逐步成形。后续村田和 SEMCO 的定价表态、下半年 ASIC 订单实际放量规模，以及 ODM 新一轮议价结果，将共同决定这一波价格反转的力道与持续性。

2、消费电子：五一期间中国智能手机销量下降 16%。

市调机构 Counterpoint Research 近日发布的《中国智能手机周报》显示，2026 年五一假期前后两周（包括第 18 周和第 19 周），中国智能手机销量同比下降 16%，主要原因是内存价格上涨推高了

电子

维持

强于大市

郭彦辉

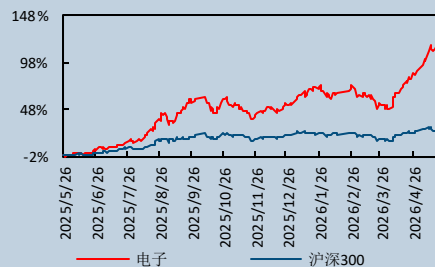
guoyanhui@csc.com.cn

021-68821629

SAC 编号:S1440520070009

发布日期：2026 年 05 月 25 日

市场表现



相关研究报告

26.05.10	【中信建投电子】:周报：晶圆代工成熟制程有望涨价，英伟达与康宁达成战略合作
26.05.09	【中信建投电子】:2026 年中期投资策略：Token 指数级增长，国产算力进入爆发期
26.05.06	【中信建投电子】:周报：闪迪 FY26Q3 业绩大超预期；华为首发乾崮 ADS5.0
26.04.26	【中信建投电子】:周报：2026 年下半年 CPU 恐迎新一轮涨价，SpaceX 计划自研 GPU
26.04.19	【中信建投电子】:周报：台积电 26Q1 业绩超预期；特斯拉 AI5 成功流片

智能手机价格，抑制了消费者的升级换代需求。此外，由于厂商更加注重盈利而非单纯追求销量，假期期间的促销力度也弱于往年。从厂商表现来看，华为继续领跑中国智能手机市场。畅享 90 Pro Max 凭借其卓越的续航能力和极高的性价比，表现尤为强劲。配合稳定的定价策略，华为自 4 月以来一直保持着 25% 以上的周销量市场份额。苹果的销售正受到季节性因素的影响，竞争对手通常会在四月份推出更强劲的新品。iPhone 17 系列在经历了六个月的强劲销售后，需求正进入一个更为正常的阶段。

3、汽车电子：禾赛成为奔驰 L3 激光雷达战略合作伙伴，将于泰国工厂投产。

5 月 19 日，全球化智能科技企业、三维感知技术领导者禾赛科技（NASDAQ: HSAI; HKEX: 2525）宣布，据公司 Q1 财报，禾赛成为梅赛德斯-奔驰（Mercedes-Benz）的激光雷达战略合作伙伴，并被确认为其 L3 级自动驾驶车型的供应商。此次签署的新供应协议将全面支持奔驰在欧洲及中国市场的车型项目，所需产能将由禾赛新落成的泰国“伽利略”制造中心提供坚实保障。

4、投资建议：

半导体：算力芯片（海光信息、龙芯中科）、存储（兆易创新）、AIoT（晶晨股份）、射频（唯捷创芯、卓胜微）、CIS（豪威集团）、模拟（圣邦股份、芯海科技）、设备（长川科技）；

消费电子：立讯精密、长盈精密、水晶光电、华勤技术；

PCB 及被动元件：鹏鼎控股、东山精密、深南电路、三环集团、顺络电子、洁美科技。

5、风险提示：

未来中美贸易摩擦可能进一步加剧，存在美国政府将继续加征关税、设置进口限制条件或其他贸易壁垒风险；宏观环境的不利因素将可能使得全球经济增速放缓，居民收入、购买力及消费意愿将受到影响，存在下游需求不及预期风险；大宗商品价格仍未企稳，不排除继续上涨的可能，存在原材料成本提高的风险；全球政治局势复杂，主要经济体争端激化，国际贸易环境不确定性增大，可能使得全球经济增速放缓，从而影响市场需求结构，存在国际政治经济形势风险。

目录

一、行情回顾 1

二、行业数据 2

三、产业要闻 5

 3.1 半导体 5

 3.2 消费电子 6

 3.3 汽车电子 6

四、重要公告 8

五、风险分析 9

图表目录

图表 1： 电子行业重要指数涨跌幅情况..... 1

图表 2： 电子行业每周股价涨幅前五名 1

图表 3： 电子行业每周股价跌幅前五名 1

图表 4： 日本半导体设备出货金额及同比 2

图表 5： 全球半导体月度销售额 2

图表 6： DDR4 价格走势（16Gb， USD） 2

图表 7： DDR5 价格走势（16Gb， USD） 2

图表 8： Flash Wafer 价格走势（512Gb TLC， USD） 2

图表 9： Flash Wafer 价格走势（1Tb TLC， USD） 2

图表 10： 全球智能手机市场各品牌份额..... 3

图表 11： 中国智能手机市场各品牌份额..... 3

图表 12： 2025 年及 2026 年中国智能手机市场各品牌周度出货量（千台） 3

图表 13： 全球液晶电视面板月度出货量..... 3

图表 14： 全球液晶面板月度营收 3

图表 15： TV 面板价格趋势 4

图表 16： Monitor 面板价格趋势 4

图表 17： Notebook 面板价格趋势..... 4

图表 18： 台股 MLCC 月度营收及同比 4

图表 19： 一周重要公告 8

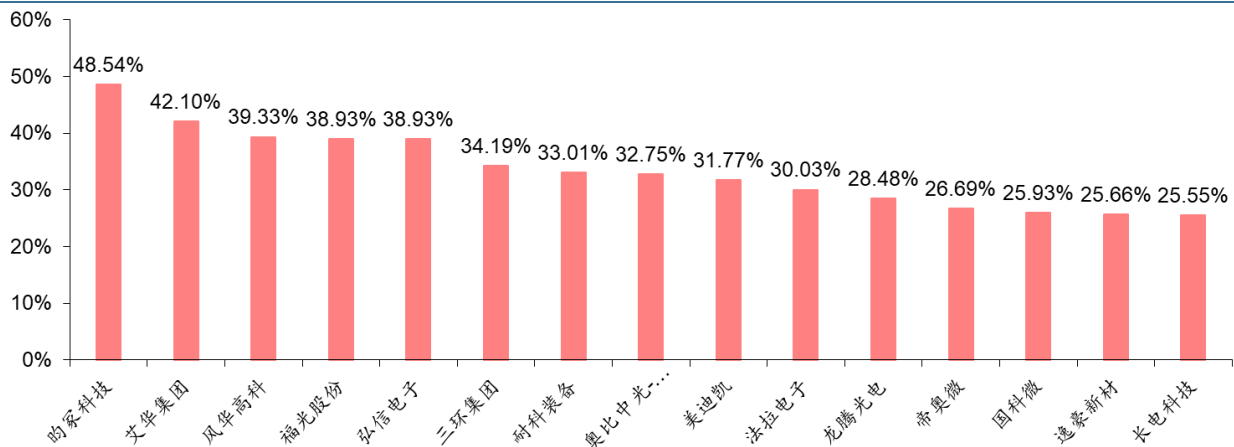
一、行情回顾

图表1： 电子行业重要指数涨跌幅情况

代码	名称	周报点	周涨跌幅	月涨跌幅	年涨跌幅
000001.SH	上证指数	4112.90	-0.54%	0.02%	3.63%
399001.SZ	深证成指	15597.30	0.23%	3.24%	15.32%
399006.SZ	创业板指	3938.50	0.24%	7.11%	22.96%
000300.SH	沪深300	4845.10	-0.30%	0.79%	4.65%
801080.SI	电子(申万)	9592.34	6.56%	18.30%	46.35%
SOX.GI	费城半导体指数	12202.54	5.30%	16.17%	72.28%
TWSE020	台湾电子指数	2752.45	3.01%	10.21%	58.42%
TWSE071	台湾半导体指数	1444.10	1.55%	10.93%	57.43%

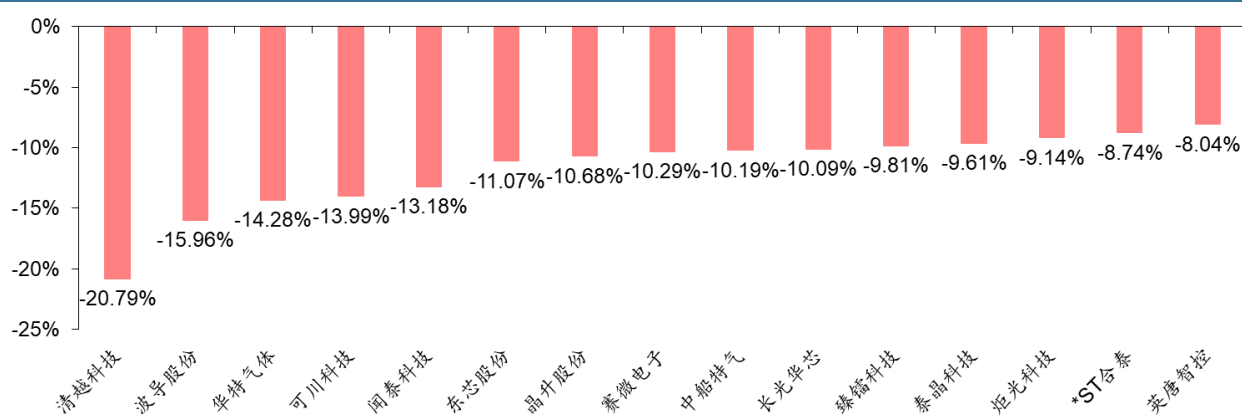
资料来源：Wind，中信建投

图表2： 电子行业每周股价涨幅前五名



资料来源：Wind，中信建投

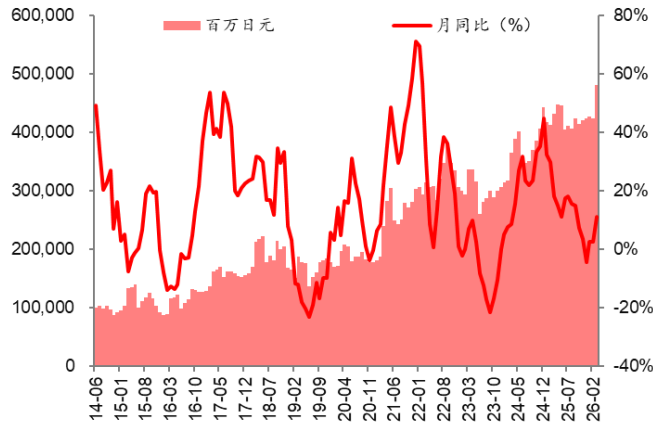
图表3： 电子行业每周股价跌幅前五名



资料来源：Wind，中信建投

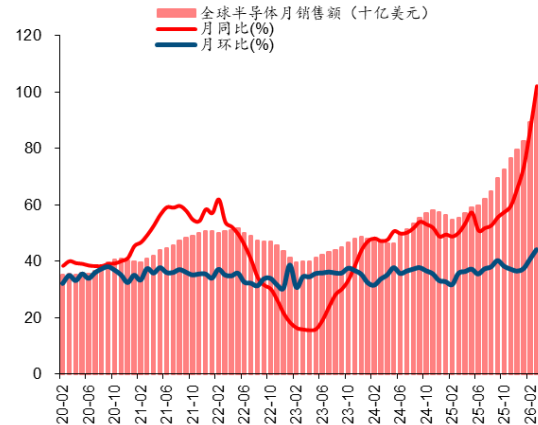
二、行业数据

图表4：日本半导体设备出货金额及同比



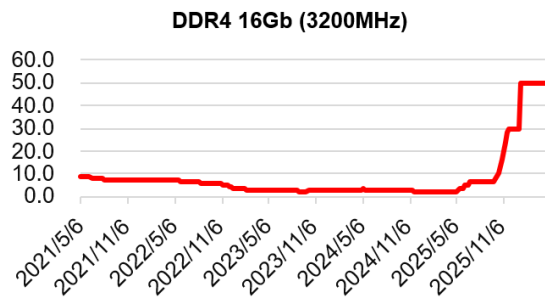
资料来源：Wind，中信建投

图表5：全球半导体月度销售额



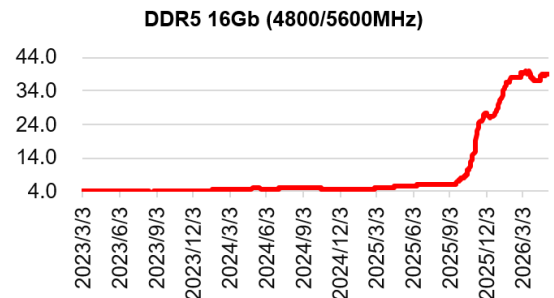
资料来源：Wind，中信建投

图表6：DDR4 价格走势（16Gb，USD）



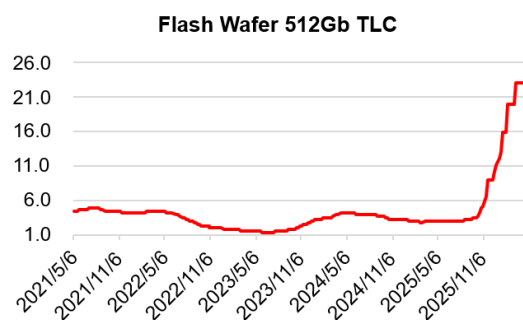
资料来源：CFM，中信建投

图表7：DDR5 价格走势（16Gb，USD）



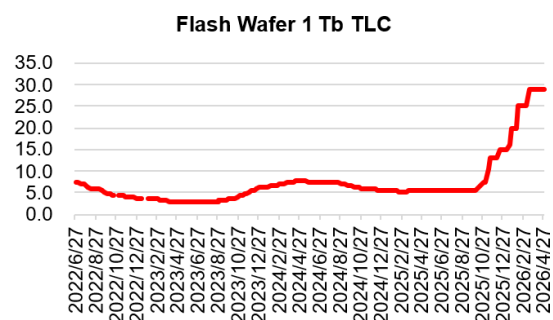
资料来源：DRAMexchange，中信建投

图表8：Flash Wafer 价格走势（512Gb TLC，USD）

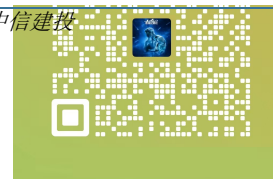


资料来源：CFM，中信建投

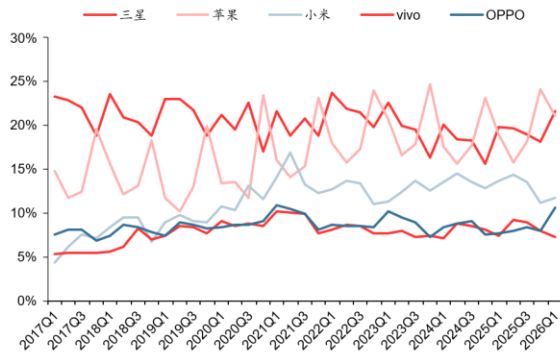
图表9：Flash Wafer 价格走势（1Tb TLC，USD）



资料来源：CFM，中信建投

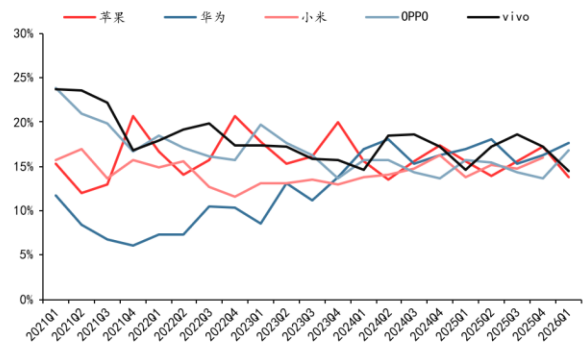


图表10：全球智能手机市场各品牌份额



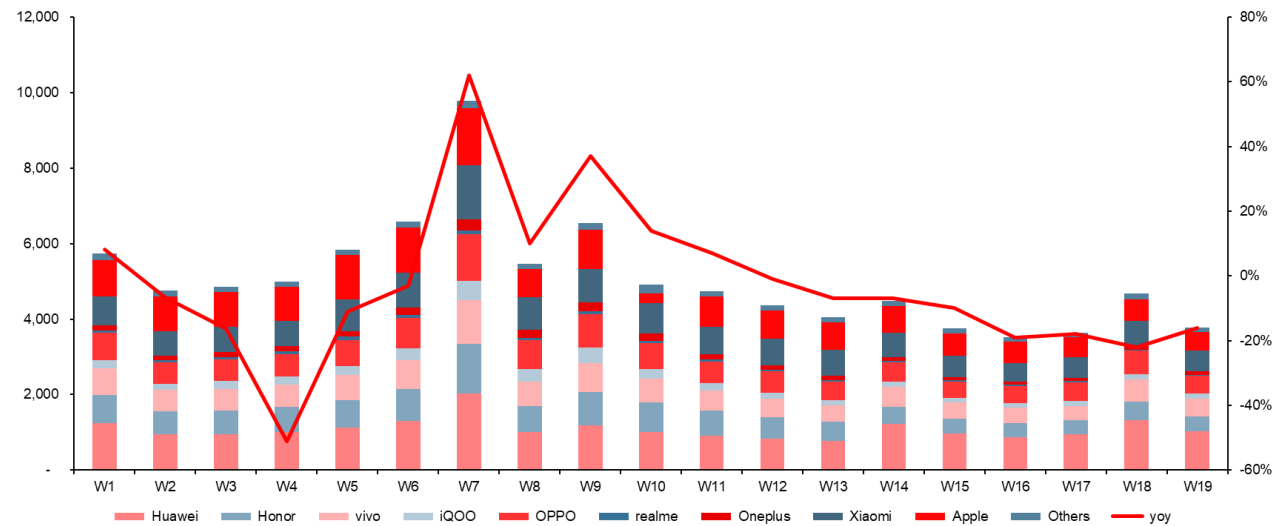
资料来源：IDC，中信建投

图表11：中国智能手机市场各品牌份额



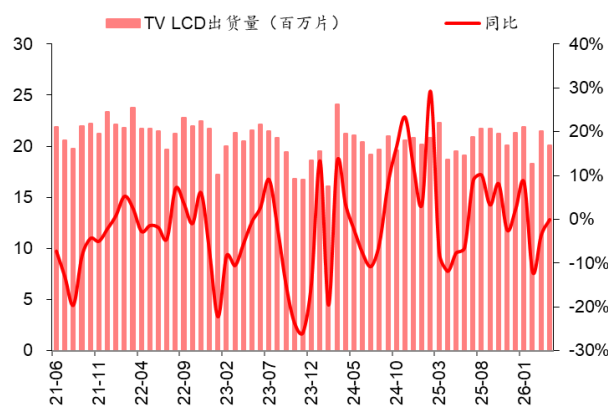
资料来源：IDC，中信建投

图表12：2025年及2026年中国智能手机市场各品牌周度出货量（千台）



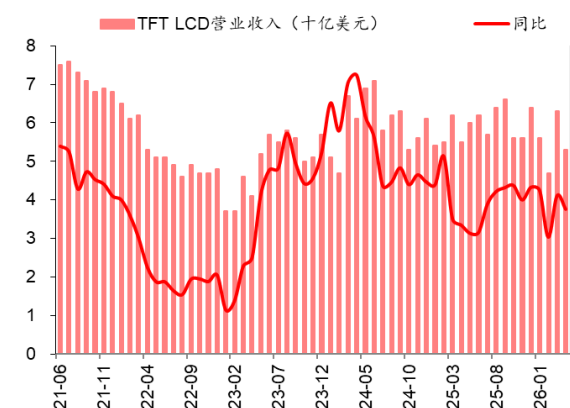
资料来源：BCI，中信建投

图表13：全球液晶电视面板月度出货量



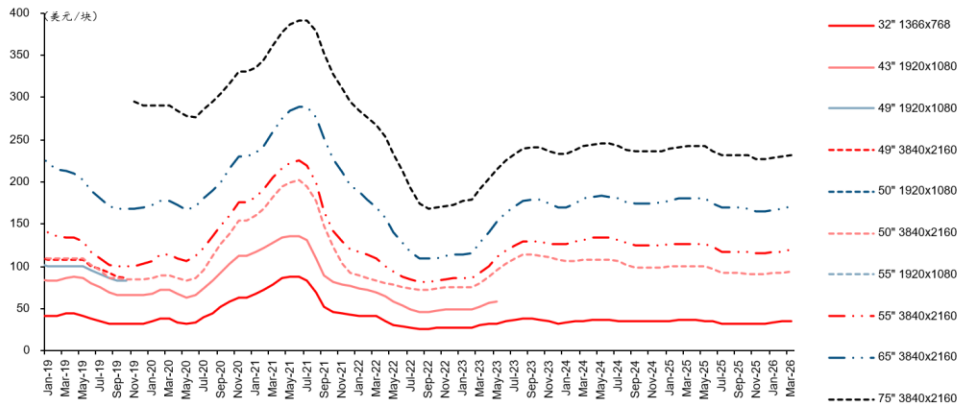
资料来源：Wind，中信建投

图表14：全球液晶面板月度营收



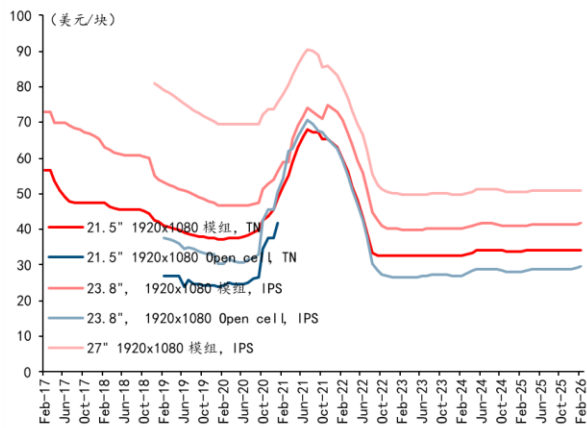
资料来源：Wind，中信建投

图表15: TV 面板价格趋势



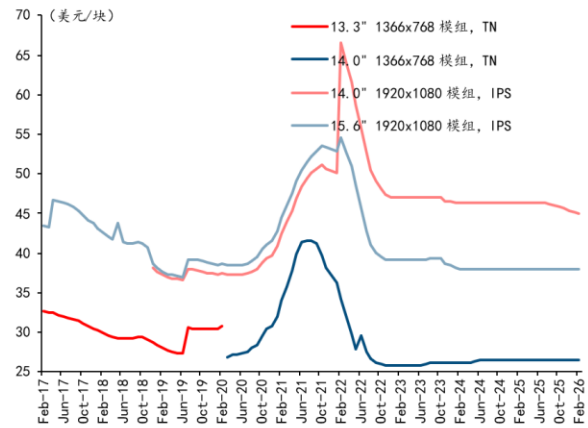
资料来源: 群智咨询, 中信建投

图表16: Monitor 面板价格趋势



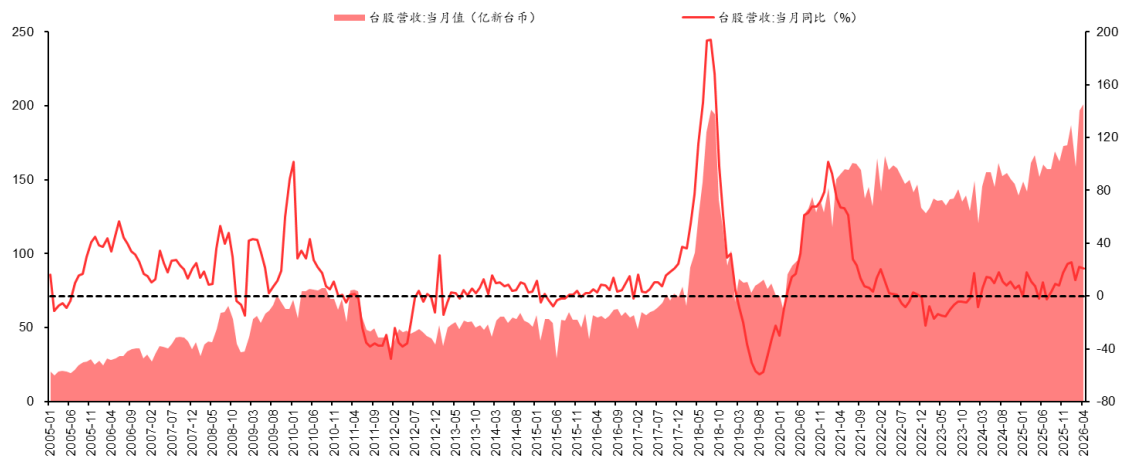
资料来源: 群智咨询, 中信建投

图表17: Notebook 面板价格趋势



资料来源: 群智咨询, 中信建投

图表18: 台股 MLCC 月度营收及同比



资料来源: Wind, 中信建投

三、产业要闻

3.1 半导体

【英特尔或借 EMIB-T 打入英伟达供应链】瑞银（UBS）近日发布研报指出，英特尔有望借 EMIB-T（嵌入式多芯片互连桥）先进封装切入英伟达 Rubin Ultra 供应链。瑞银判断，英伟达到 2027 年前后的毛利率，大体可维持在约 75% 区间。与此同时，利润空间会在一定程度上受到 Rubin 产品组合影响，尤其取决于 Rubin Ultra 是否会同时提供 2 芯片和 4 芯片两个版本。其中，4 芯片版被认为较可能采用英特尔 EMIB-T。不过，这一判断仍属推测，不代表英伟达已经正式拍板。报道也引用其他分析称，EMIB-T 能否大规模导入，还要看基板产能与良率表现。此前市场已有观点指出，原材料与基板生产能力，可能决定该技术能否满足当代半导体制造对规模化的要求。（Techsugar）

【TrendForce：高端需求扩张与消费类渠道囤货升温有望催化 MLCC 价格反转】根据 TrendForce 调查，旺盛的 AI 芯片需求导致高端 MLCC 供需偏紧，并压缩消费类 MLCC 供货，促使部分代理商展开预防性囤货，供应商则以调价回应。近期 ODM 与供应商议价结果也显示，整体 MLCC 价格平均降幅创下近三年新低，显示 MLCC 价格循环已来到反转向上的关键点。根据 TrendForce 调查，部分 ODM 已于 5 月上旬完成 2026 年第三季议价。在供应链涨价氛围带动下，整体 MLCC 价格平均降幅不到 0.5%，创近三年新低，充分反映卖方定价话语权正显著回升。随着多数 ODM 从 5 月下旬起陆续展开新一轮议价，目前的氛围是否能催化 MLCC 价格全面反转，将成为后续观察重点。TrendForce 表示，当前高端 MLCC 受 AI Server 及 ASIC 封测订单驱动，供给偏紧，短期内难以改善；消费类产品方面则因 Taiyo Yuden 已涨价、SEMCO 评估跟进，价格底部支撑逐步成形。后续村田和 SEMCO 的定价表态、下半年 ASIC 订单实际放量规模，以及 ODM 新一轮议价结果，将共同决定这一波价格反转的力道与持续性。（Techsugar）

【ADI 拟收购 Empower】据外媒报道，ADI 正与 Empower Semiconductor 公司进行深入谈判，拟以 15 亿美元现金收购这家非上市公司。知情人士透露，最终协议尚未达成，细节可能会有所变动，谈判也可能无果。据悉，Empower Semiconductor 总部位于美国加利福尼亚州米尔皮塔斯，主要生产用于电压调节的芯片，其产品广泛应用于数据中心。该公司此前宣布，已完成由 Fidelity Management & Research Co. 领投的 D 轮融资，融资额超过 1.4 亿美元。（Techsugar）

【长江存储启动 IPO 辅导】据证监会网站披露，长江存储控股股份有限公司在湖北证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为中信证券。据路透社此前报道，长江存储计划最快在 2026 年 6 月中旬正式递交科创板 IPO 申请材料。长江存储 2026 年第一季度营收突破 200 亿元人民币，同比增长约 100%。强劲的业绩增长主要受益于全球存储芯片市场，特别是 AI 驱动下的数据中心需求爆发。（Techsugar）

【苹果硬件团队进行第二轮重组】据彭博社报道称，苹果新任首席硬件官约翰尼·斯鲁吉（Johnny Srouji）正推动上任后的第二轮团队重组，重点是重新分配产品设计、硬件工程和关键底层技术团队的职责。在本轮调整中，苹果公司主要产品设计原本由凯特伯杰龙（Kate Bergeron）负责，接下来将交给她的两名副手 Shelly Goldberg 和 Dave Pakula 分担。伯杰龙的新职位是接替汤姆马里布（Tom Marib），统筹所有产品可靠性工作，并继续负责材料使用相关团队。而马里布接任负责苹果的硬件工程部门，负责实体产品的研发、生产与品控。（Techsugar）

【俄罗斯联邦储蓄银行拟采购中国 AI 芯片】据路透社报道，俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）首席执行官 German Gref 希望借助中国制造芯片，为其 AI 模型“GigaChat”提供算力支持。俄罗斯联邦储蓄银行目前拥有 GigaChat AI 模型，该公司近年来一直在推动自主 AI 发展战略。不过俄罗斯从中国采购芯片的计划很可能面临激烈竞争。字节跳动、阿里巴巴、腾讯等公司都在争相订购华为昇腾 950 芯片。但 Gref 并未透露俄罗斯联邦储蓄银行具体希望采购哪款芯片。（Techsugar）

【AMD 计划在中国台湾投资超 100 亿美元】AMD 承诺在中国台湾投资超过 100 亿美元，以拓展合作伙伴关系并提升封装产能。AMD 表示，正与包括日月光科技、力成科技、新美亚电子和英业达在内的合作伙伴携手，增强其在中国台湾地区的实力。其还将与矽品精密合作，为人工智能系统和处理器开发更节能的技术。随着人工智能需求的增长，AMD 和其他芯片制造商正积极扩大在中国台湾的业务。中国台湾是全球半导体产业的关键技术和制造中心，AMD 希望借此提升产能。（Techsugar）

【消息称台积电推进 310×310 毫米面板级封装】TrendForce 发文称，基于德国设备商 SCHMID 透露，台积电正推进面板级封装，重点规格为 310×310 毫米，并在同尺寸上评估玻璃材料整合。德国设备商 SCHMID 首席销售官 Roland Rettenmaier 表示，包括台积电、英特尔和三星在内，整个行业正逐步走向标准化，目前主流有 310×310 毫米、510×515 毫米、600×600 毫米等多种面板尺寸。（Techsugar）

3.2 消费电子

【五一期间中国智能手机销量下降 16%】市调机构 Counterpoint Research 近日发布的《中国智能手机周报》显示，2026 年五一假期前后两周（包括第 18 周和第 19 周），中国智能手机销量同比下降 16%，主要原因是内存价格上涨推高了智能手机价格，抑制了消费者的升级换代需求。此外，由于厂商更加注重盈利而非单纯追求销量，假期期间的促销力度也弱于往年。从厂商表现来看，华为继续领跑中国智能手机市场。畅享 90 Pro Max 凭借其卓越的续航能力和极高的性价比，表现尤为强劲。配合稳定的定价策略，华为自 4 月以来一直保持着 25% 以上的周销量市场份额。苹果的销售正受到季节性因素的影响，竞争对手通常会在四月份推出更强劲的新品。iPhone 17 系列在经历了六个月的强劲销售后，需求正进入一个更为正常的阶段。（Techsugar）

【2026 年 Q1 东南亚智能手机市场平均售价同比大增 19%】据机构 Omdia 近日统计数据表示，东南亚智能手机市场平均售价 (ASP) 在 2026 年 Q1 出现了 19% 的显著同比增幅，达到创纪录的 349 美元（现约合 2378 元人民币）。考虑到该地区超过 60% 的智能手机售价低于 200 美元，一季度的涨价对当地市场造成了严重冲击：合计出货量仅有 2160 万部，出现 9% 同比下滑。但总市场规模仍在均价的推动下实现了 8% 同比增长。（Techsugar）

3.3 汽车电子

【中国汽车零部件已渗透美国市场】据《华尔街日报》报道，艾睿铂咨询公司数据显示，目前美国境内有超过 60 家汽车供应商由中国企业全资或控股持有，中国公司还在全美约 1 万家供应商中掌握了大约 5% 的股权。据 CNBC 报道，福特最新款 Mustang GT 使用了中国的六速手动变速箱、丰田普锐斯插混版约有 15% 的零件来自中国、雪佛兰 Blazer 和 Equinox 电动 SUV 使用了约 20% 的中国零件。艾睿铂合伙人 Juergen Simon 指出，2012

年全球汽车零部件百强中只有一家中国企业，到 2024 年这一数字已增至 13 家，预计到 2030 年前将达到 22 家。
(Techsugar)

【禾赛成为奔驰 L3 激光雷达战略合作伙伴，将于泰国工厂投产】5 月 19 日，全球化智能科技企业、三维感知技术领导者禾赛科技（NASDAQ: HSAI；HKEX: 2525）宣布，据公司 Q1 财报，禾赛成为梅赛德斯-奔驰（Mercedes-Benz）的激光雷达战略合作伙伴，并被确认为其 L3 级自动驾驶车型的供应商。此次签署的新供应协议将全面支持奔驰在欧洲及中国市场的车型项目，所需产能将由禾赛新落成的泰国“伽利略”制造中心提供坚实保障。（禾赛科技）

四、重要公告

图表19：一周重要公告

公司名称	发布日期	公告内容
华海诚科	2026/05/25	公司于2026年5月25日发布股东减持计划公告，公司股东天水华天科技拟通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的全部股份，减持股份占公司总股份比例不超过2.4%。
东微半导	2026/05/25	公司于2026年5月25日发布股东减持计划公告，公司股东得数聚才拟拟通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过1125794股，占公司总股本比例0.92%。
中微公司	2026/05/23	公司于2026年5月23日发布大股东减持股份计划公告，公司股东巽鑫投资拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股票不超过总股本的2%。

来源：Wind，中信建投

五、风险分析

未来中美贸易摩擦可能进一步加剧，存在美国政府将继续加征关税、设置进口限制条件或其他贸易壁垒风险；目前仍处于 5G 网络普及阶段，相关技术成熟度还有待提升，应用尚未形成规模，存在 5G 应用不及预期风险；宏观环境的不利因素将可能使得全球经济增速放缓，居民收入、购买力及消费意愿将受到影响，存在下游需求不及预期风险；大宗商品价格仍未企稳，不排除继续上涨的可能，存在原材料成本提高的风险；全球政治局势复杂，主要经济体争端激化，国际贸易环境不确定性增大，可能使得全球经济增速放缓，从而影响市场需求结构，存在国际政治经济形势风险。

分析师介绍

郭彦辉：电子行业分析师。复旦大学金融硕士，3 年量化选股研究，2018 及 2019 年 Wind 金牌分析师金融工程第 2 名团队成员，2021 年加入中信建投电子团队，专注研究激光、消费电子、半导体领域。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15%以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：（i）以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。（ii）本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
朝阳区景辉街16号院1号楼18层
电话：（8610）8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路528号南塔2103室
电话：（8621）6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区福中三路与鹏程一路交汇处广电金融中心35楼
电话：（86755）8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场2期18楼
电话：（852）3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk